

2024年3月期

決算説明会

2024/05/24

01

2024年3月期決算の概要

02

2025年3月期の見通し

03

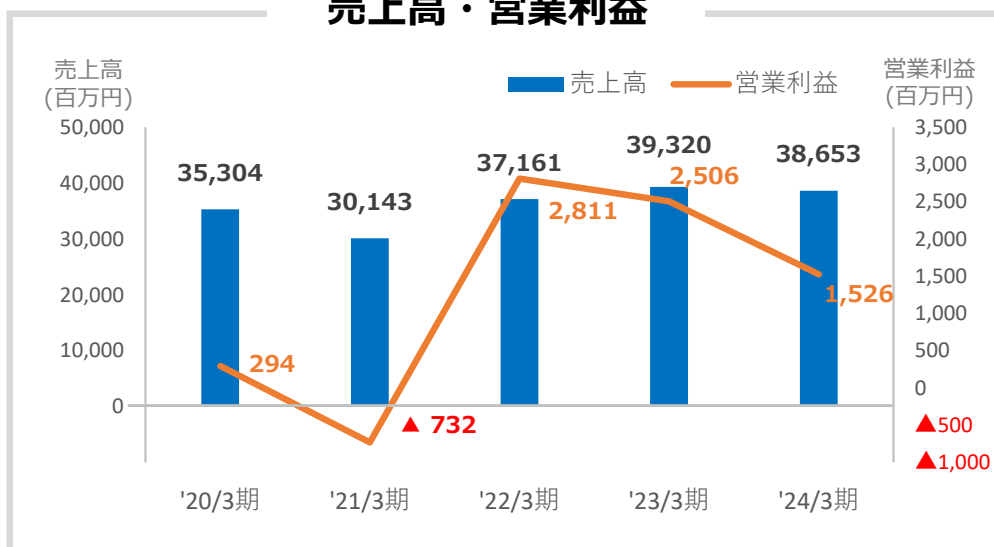
中期経営計画の進捗

決算概要（連結）

単位：百万円

	'23年3月期		'24年3月期			
	実績	百分比 %	実績	百分比 %	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
売上高	39,320	100.0	38,653	100.0	▲667	▲1.7
営業利益	2,506	6.4	1,526	4.0	▲979	▲39.1
経常利益	3,275	8.3	2,408	6.2	▲867	▲26.5
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,765	7.0	2,109	5.5	▲656	▲23.7
1株あたり純利益(円)	50.88	-	40.57	-	▲10.31	-

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

増加要因

- 変動費率の減少 5億円
- 退職給付費用の減少 2億円

減少要因

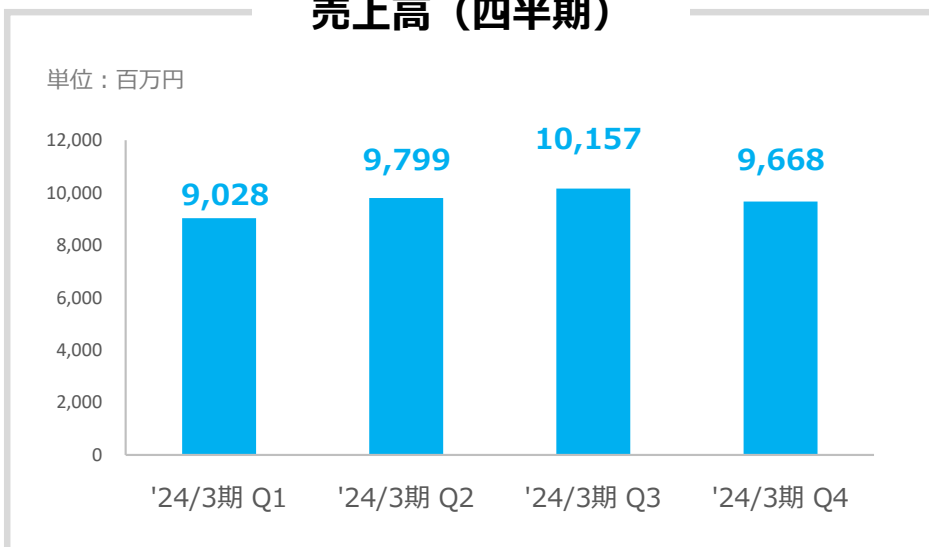
- 売上の減少 4億円
- 人件費の増加 2億円
- 工場再編費用等 3億円
- その他（旅費交通費等） 6億円

四半期別実績推移（連結）

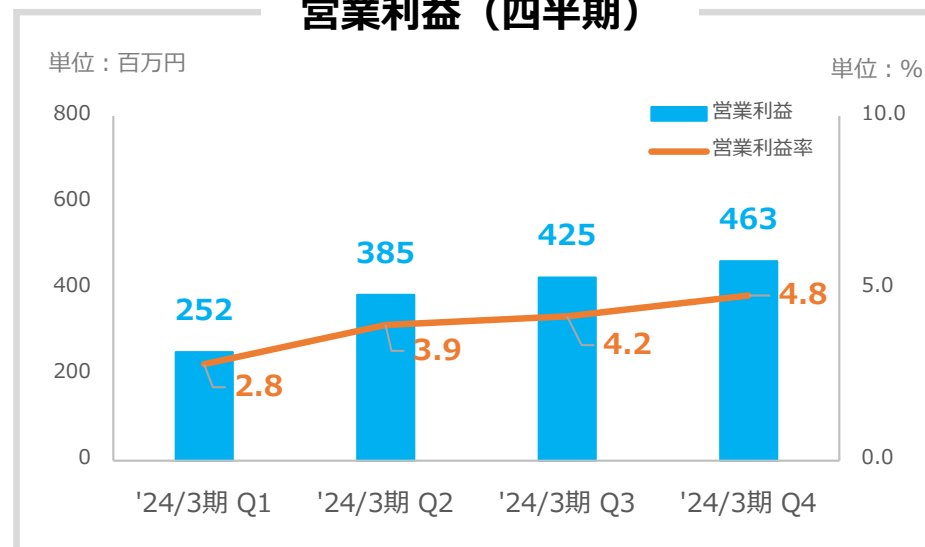
単位：百万円

	'24年3月期							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%
売上高	9,028	100.0	9,799	100.0	10,157	100.0	9,668	100.0
営業利益	252	2.8	385	3.9	425	4.2	463	4.8
経常利益	556	6.2	659	6.7	585	5.8	607	6.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	532	5.9	737	7.5	422	4.2	417	4.3

売上高（四半期）



営業利益（四半期）

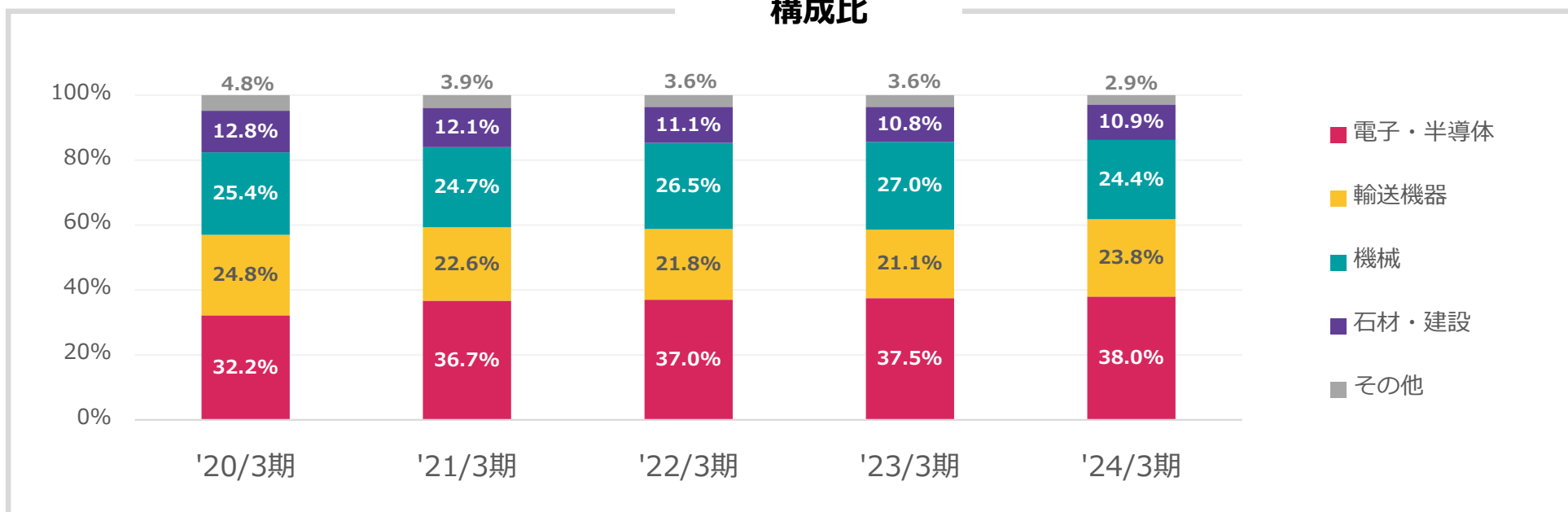


業界別売上高 及び 構成比 (連結)

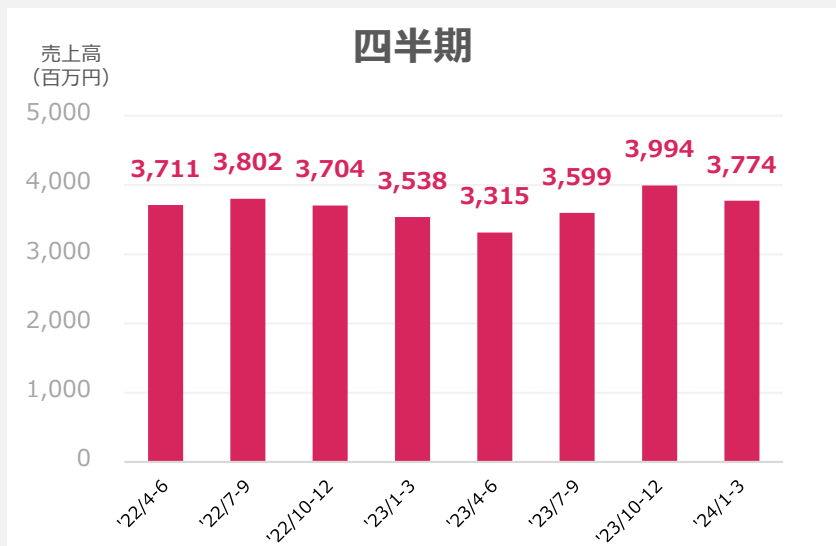
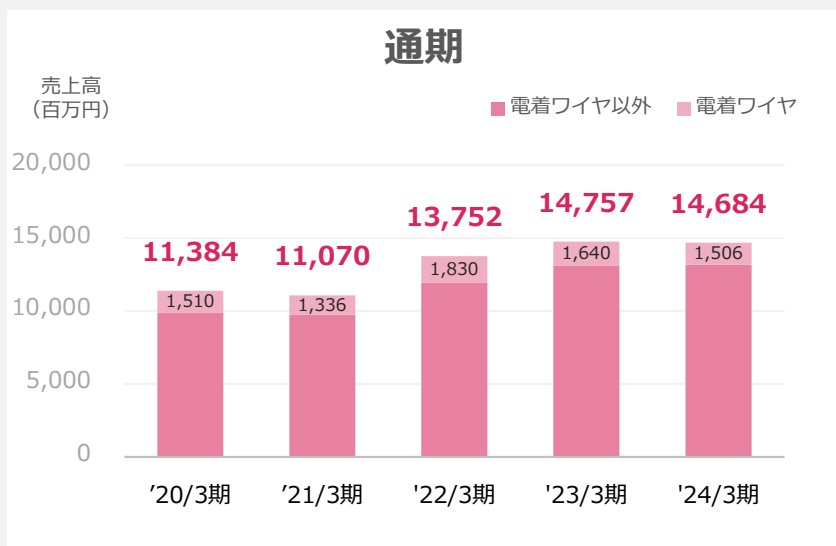
単位：百万円

	'23年3月期		'24年3月期			
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 電子・半導体	14,757	37.5	14,684	38.0	▲72	▲0.5
■ 輸送機器	8,282	21.1	9,204	23.8	922	11.1
■ 機械	10,640	27.0	9,434	24.4	▲1,206	▲11.3
■ 石材・建設	4,239	10.8	4,218	10.9	▲21	▲0.5
■ その他	1,401	3.6	1,111	2.9	▲289	▲20.7
合計	39,320	100.0	38,653	100.0	▲667	▲1.7

構成比



業界別売上高：①電子・半導体（電着ダイヤモンドワイヤ含む）



半導体・電子部品

電子部品の需要が低迷したものの、パワー半導体向け関連工具が増加し、販売が増加

FPD

主要販売先の需要低迷により、販売が減少

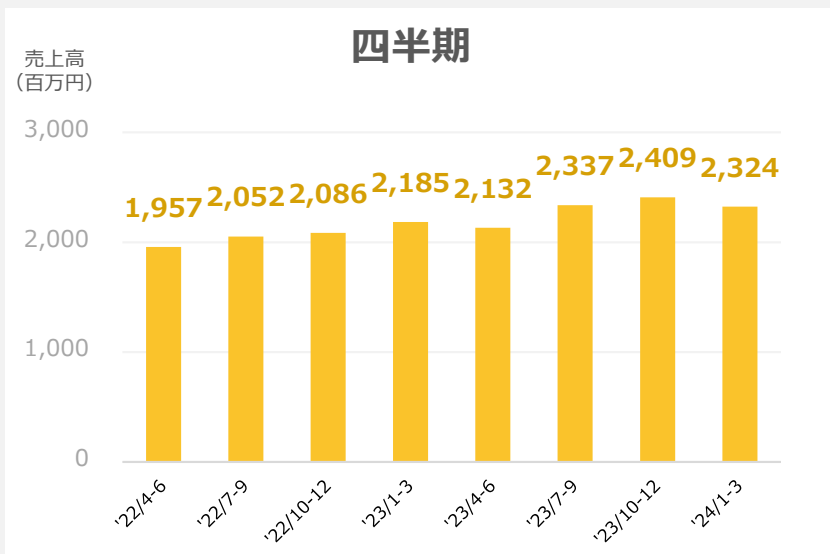
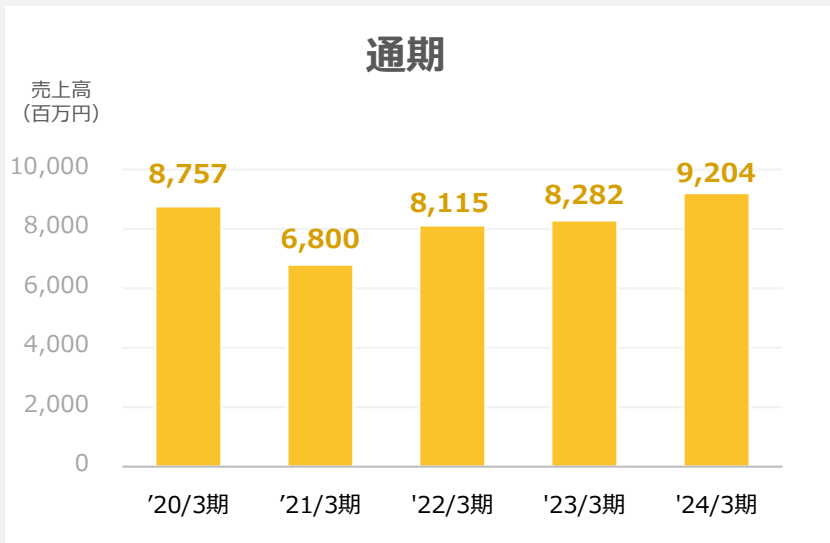
伸線

半導体の需要低迷の中、特殊線の販売が増加

電着ダイヤモンドワイヤ

パワー半導体向けは増加したものの、全体では販売が減少

業界別売上高：②輸送機器



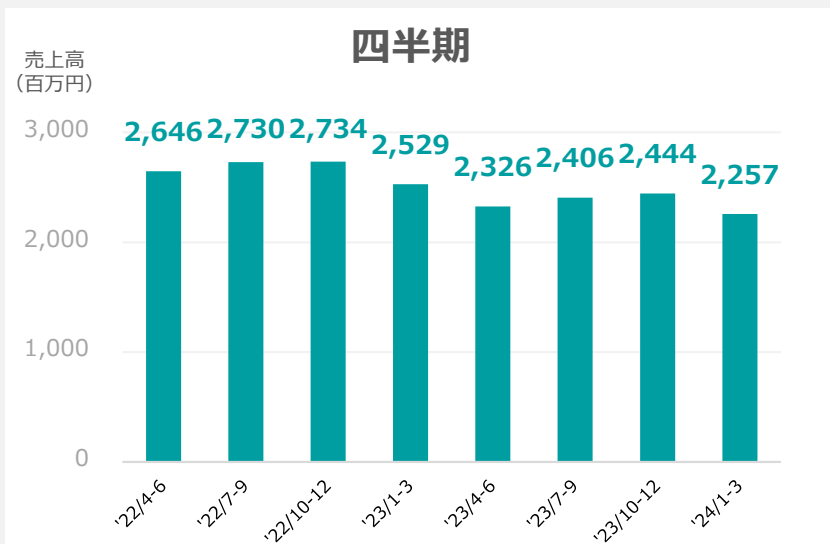
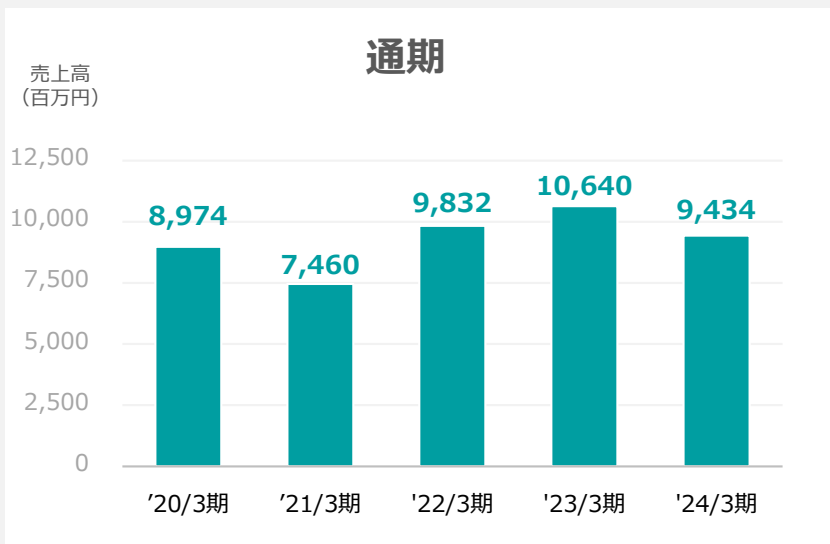
自動車

半導体不足の解消による自動車生産の回復を中心に
関連工具の販売が増加

航空機

需要の回復及び拡販が進んだことで
関連工具の販売が増加

業界別売上高：③機械



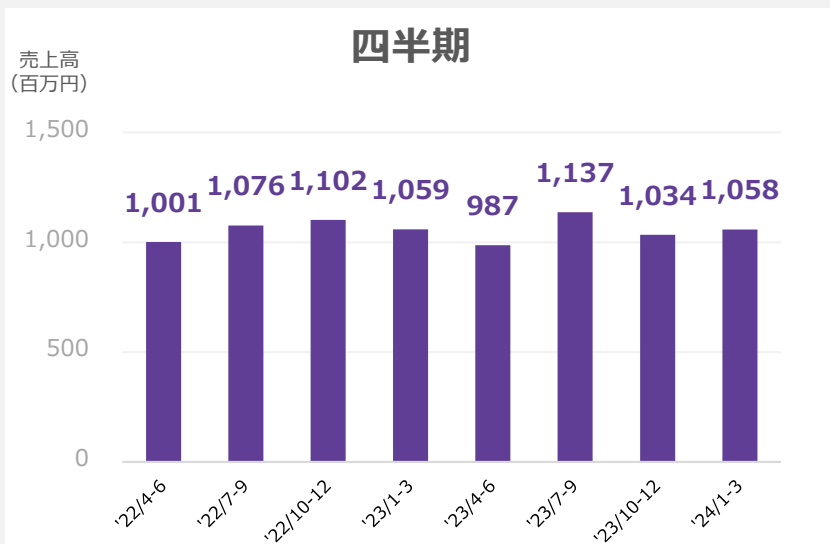
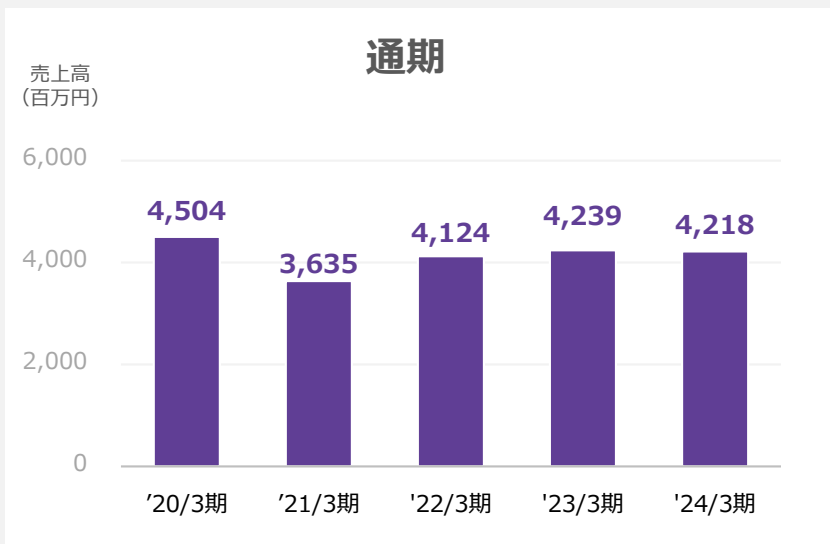
軸受・超硬工具

電子・半導体市場の需要低迷により、
軸受・超硬工具メーカーへの関連工具の販売が減少

工作機械

半導体用の工作機械での販売が進んだものの
工作機械の需要低迷により関連工具の販売が微減

業界別売上高：④石材・建設



資源探査

海外の受注が堅調に推移し、販売が増加

国内建設

高速道路の補修工事や国土強靱化等の施策もあり、
関連工具の販売が増加

流通商品(ポータブルカッタ)

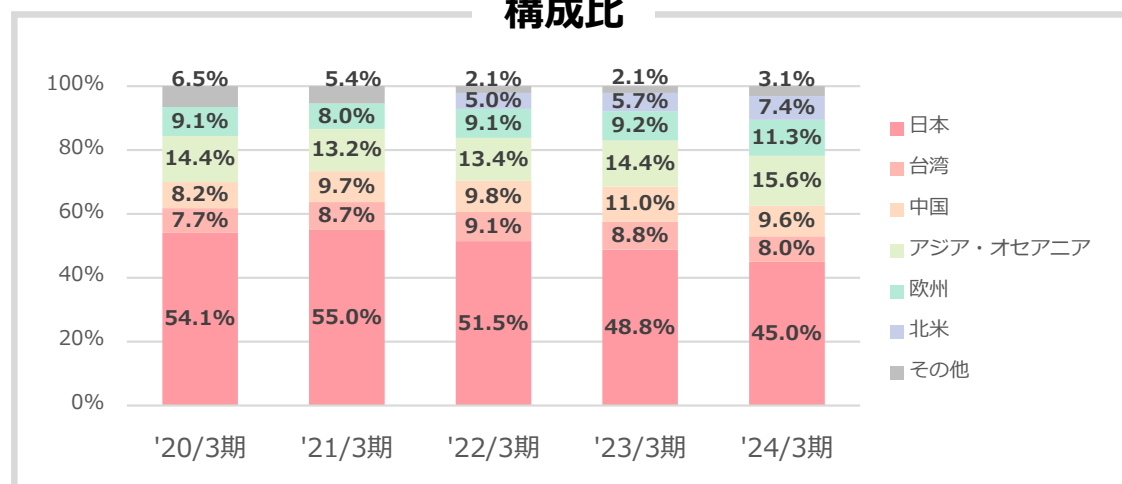
海外の需要が低迷し、販売が減少

地域別売上高 及び 構成比 (連結)

単位：百万円

	'23年3月期		'24年3月期			
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 日本	19,179	48.8	17,387	45.0	▲1,792	▲9.3
■ 台湾	3,454	8.8	3,080	8.0	▲373	▲10.8
■ 中国	4,320	11.0	3,704	9.6	▲616	▲14.3
■ その他アジア・オセアニア	5,676	14.4	6,041	15.6	364	6.4
■ 欧州	3,605	9.2	4,366	11.3	761	21.1
■ 北米	2,244	5.7	2,885	7.4	641	28.6
■ その他	838	2.1	1,187	3.1	348	41.5
海外計	20,141	51.2	21,266	55.0	1,125	5.6
合計	39,320	100.0	38,653	100.0	▲667	▲1.7

構成比



日本
「電子・半導体」「機械」を中心に販売が減少

中国
「電子・半導体」を中心に販売が減少

欧州・北米
「電子・半導体」「輸送機器」で販売が増加

連結貸借対照表

単位：百万円

資産の部	'23年3月末	'24年3月末	増減
現金及び預金	16,375	12,780	▲3,594
受取手形及び売掛金	10,059	10,387	327
棚卸資産	7,220	8,185	964
有形固定資産	25,061	26,655	1,593
無形固定資産	190	351	160
投資有価証券	12,861	13,164	303
その他	2,407	2,376	▲31
資産合計	74,177	73,901	▲275

負債の部	'23年3月末	'24年3月末	増減
支払手形及び買掛金	1,477	1,424	▲53
未払法人税等	503	504	0
退職給付に係る負債	5,151	2,745	▲2,406
その他	4,161	5,235	1,073
負債合計	11,295	9,908	▲1,386

純資産の部	'23年3月末	'24年3月末	増減
純資産合計	62,882	63,993	1,110
負債純資産合計	74,177	73,901	▲275

連結キャッシュフロー計算書

単位：百万円

	'23年3月末	'24年3月末	増減
税金等調整前当期純利益	3,830	3,106	▲723
減価償却費	2,882	2,969	87
退職給付に係る負債の増減額（▲は減少）	▲162	▲436	▲274
売上債権の増減額（▲は減少）	774	52	▲721
棚卸資産の増減額（▲は減少）	▲337	▲684	▲347
法人税等の支払額	▲748	▲929	▲180
その他	▲1,259	▲1,238	20
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	4,979	2,839	▲2,139
有形固定資産の取得/売却による支出/収入	▲1,876	▲4,246	▲2,369
投資有価証券の取得/売却による支出/収入	662	1,041	378
その他	▲45	▲299	▲254
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲1,260	▲3,505	▲2,245
自己株式の取得/売却による支出/収入	▲1,512	▲1,726	▲214
配当金の支払額	▲1,479	▲1,581	▲102
その他	▲153	187	340
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲3,145	▲3,121	23
現金及び現金同等物の期末残高	16,389	12,818	▲3,570

01

2024年3月期決算の概要

02

2025年3月期の見通し

03

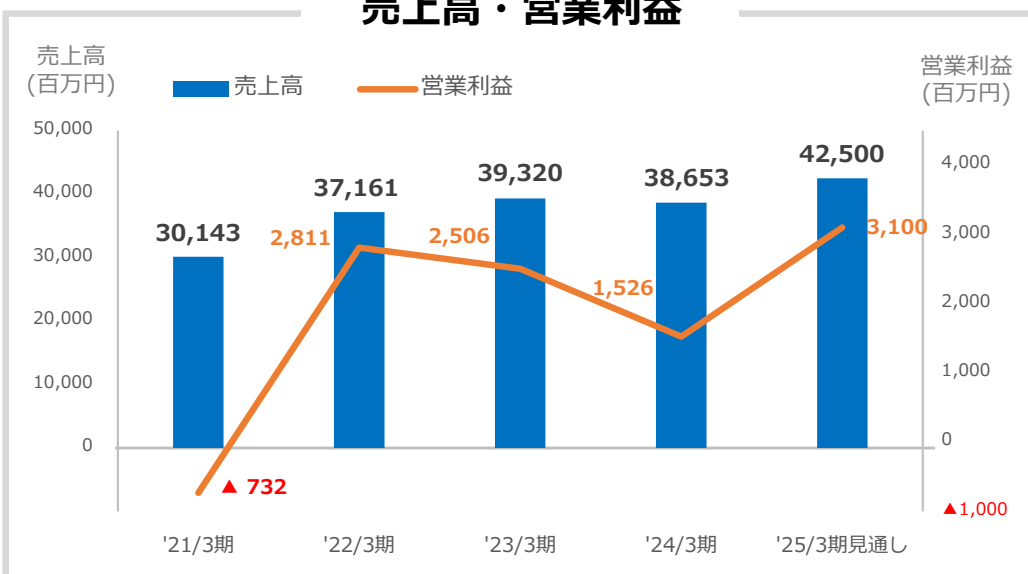
中期経営計画の進捗

見通し概要 (連結)

単位：百万円

	'24年3月期 上期実績	百分比%	'25年3月期 上期見通し	百分比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'24年3月期 通期実績	百分比%	'25年3月期 通期見通し	百分比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
売上高	18,827	100.0	20,000	100.0	1,172	6.2	38,653	100.0	42,500	100.0	3,846	10.0
営業利益	638	3.4	900	4.5	261	41.0	1,526	4.0	3,100	7.3	1,573	103.0
経常利益	1,215	6.5	1,050	5.3	▲165	▲13.6	2,408	6.2	3,500	8.2	1,091	45.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	1,269	6.7	850	4.3	▲419	▲33.1	2,109	5.5	2,600	6.1	490	23.3
JPY/USD							140.4	-	141.0			
為替レート JPY/EUR							152.0	-	156.0			
JPY/CNY							19.80	-	20.57			

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

増加要因

- 売上の増加 26億円
- 変動費率の減少 5億円
- 工場再編費用等の減少 3億円
- 退職給付費用の減少 2億円

減少要因

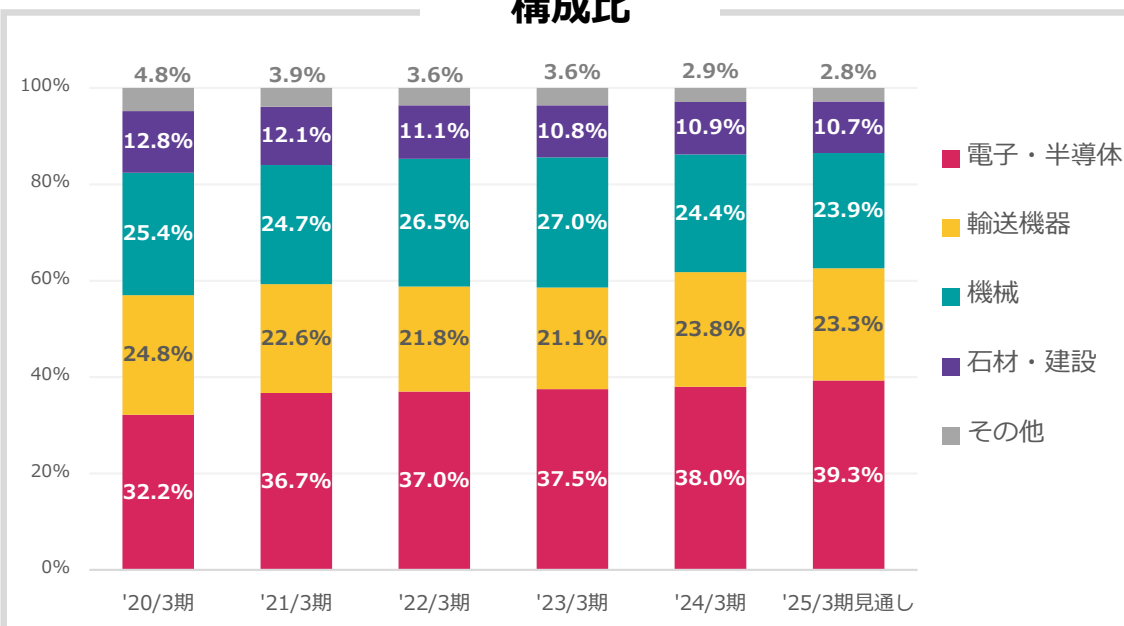
- 人件費の増加 11億円
- 減価償却費の増加 4億円
- その他（旅費交通費等） 5億円

業界別売上高 及び 構成比見通し (連結)

単位：百万円

	'24年3月期 上期実績	構成比%	'25年3月期 上期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'24年3月期 通期実績	構成比%	'25年3月期 通期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 電子・半導体	6,915	36.7	7,700	38.5	784	11.4	14,684	38.0	16,720	39.3	2,035	13.9
■ 輸送機器	4,469	23.8	4,750	23.8	280	6.3	9,204	23.8	9,880	23.3	675	7.3
■ 機械	4,733	25.1	4,780	23.9	46	1.0	9,434	24.4	10,170	23.9	735	7.8
■ 石材・建設	2,125	11.3	2,208	11.0	82	3.9	4,218	10.9	4,550	10.7	331	7.9
■ その他	584	3.1	562	2.8	▲22	▲3.9	1,111	2.9	1,180	2.8	68	6.1
合計	18,827	100.0	20,000	100.0	1,172	6.2	38,653	100.0	42,500	100.0	3,846	10.0

構成比



■ 電子・半導体

パワー半導体向けを中心に関連工具の販売は増加

■ 輸送機器

自動車業種を中心に関連工具の販売は増加

■ 機械

超硬工具・軸受業種を中心に関連工具の販売は増加

■ 石材・建設

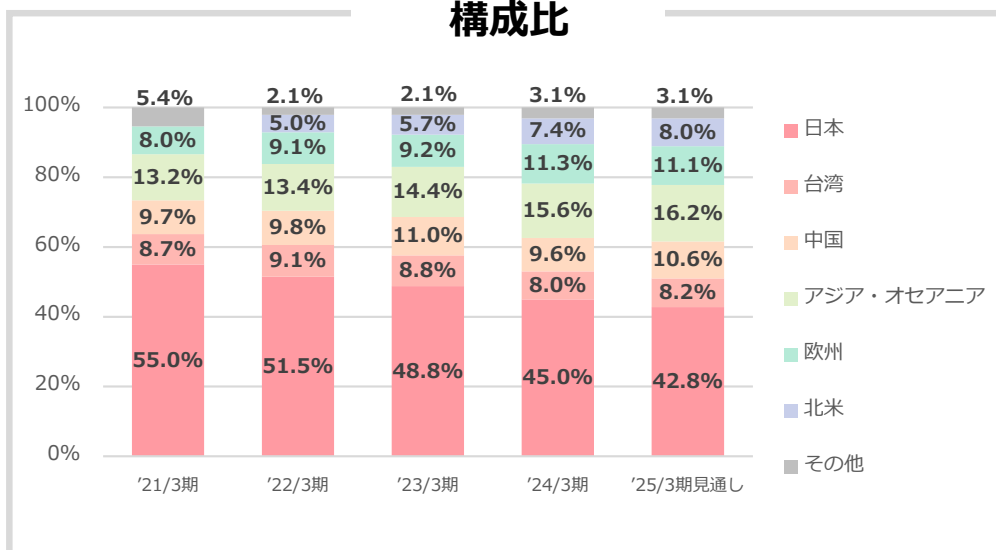
建設業種を中心に関連工具の販売は増加

地域別売上高 及び 構成比見通し (連結)

単位：百万円

	'24年3月期 上期実績	構成比%	'25年3月期 上期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'24年3月期 通期実績	構成比%	'25年3月期 通期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
日本	8,615	45.8	8,600	43.0	▲15	▲0.2	17,387	45.0	18,200	42.8	812	4.7
台湾	1,513	8.0	1,700	8.5	186	12.3	3,080	8.0	3,500	8.2	419	13.6
中国	1,741	9.2	2,000	10.0	258	14.8	3,704	9.6	4,500	10.6	795	21.5
その他アジア・オセアニア	2,966	15.8	3,300	16.5	333	11.2	6,041	15.6	6,900	16.2	858	14.2
欧州	2,164	11.5	2,400	12.0	235	10.9	4,366	11.3	4,700	11.1	333	7.6
北米	1,254	6.7	1,400	7.0	145	11.6	2,885	7.4	3,400	8.0	514	17.8
その他	570	3.0	600	3.0	29	5.1	1,187	3.1	1,300	3.1	112	9.5
海外計	10,212	54.2	11,400	57.0	1,187	11.6	21,266	55.0	24,300	57.2	3,033	14.3
合計	18,827	100.0	20,000	100.0	1,172	6.2	38,653	100.0	42,500	100.0	3,846	10.0

構成比



日本

電子・半導体業界向けを中心に関連工具の販売は増加

中国

その他アジア・オセアニア

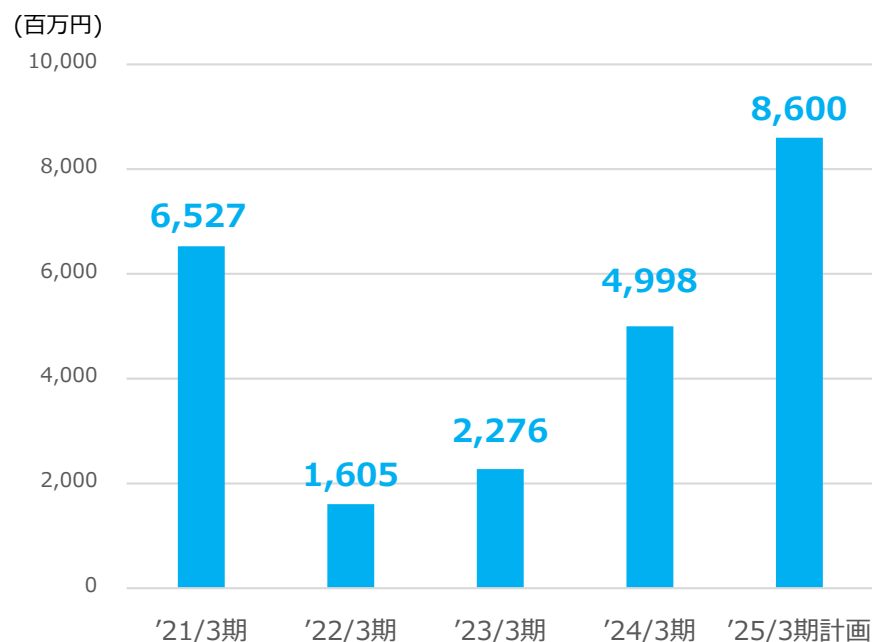
欧州

北米

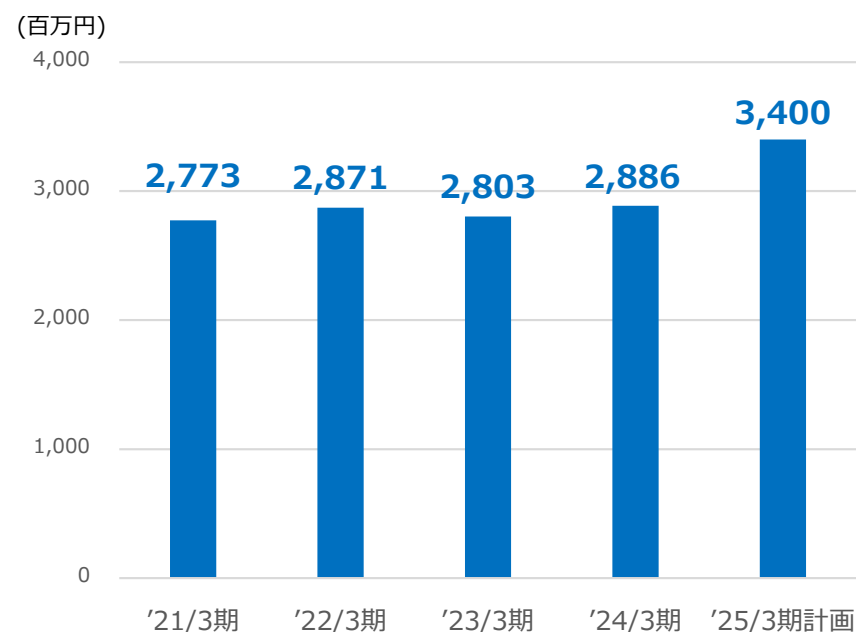
電子・半導体業界、輸送機器業界向けを中心に
関連工具の販売は増加

設備投資実績 及び 計画

設備投資額



減価償却額



設備投資額

2024年3月期は、電子・半導体向け工具の生産能力増強及び生産体制の再編で増加

2025年3月期は、電子・半導体向け工具の生産能力の増強、旭ダイヤモンドヨーロッパの工場移転と建設により増加

01

2024年3月期決算の概要

02

2025年3月期の見通し

03

中期経営計画の進捗

▼ 「VISION2030」で目指す当社のあるべき姿 ▼

世界のモノづくりを支えるグローバルニッチトップメーカーへ

実現に向けた3つの要素

ブランド力の強化

市場浸透による拡販

成長分野/得意分野に注力

経営リソースの効果的な活用

先見的な製品開発

顧客ニーズの一步先へ

事業成長に向けた3つの重点施策

1

半導体注力

2

経営基盤強化

3

リソースの最適化

1

半導体注力

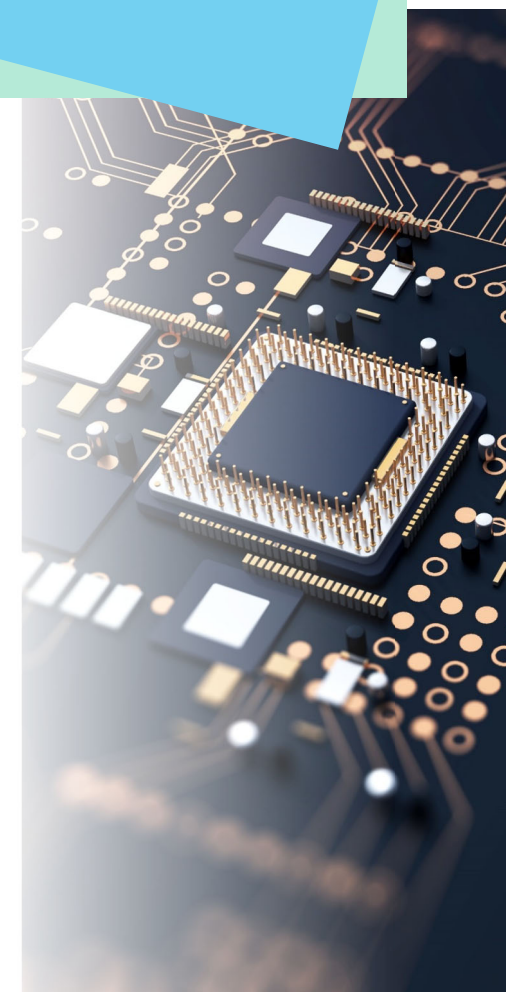
電子半導体セグメントに経営資源を集中させ、
高収益&業界のニッチトップを目指す

▶ 開発・製造

- 脱炭素にも貢献する需要拡大中のパワー半導体用SiC向け工具の開発
- 工場再編による増産体制の構築
- 生産効率及び原価率の改善

▶ 販売

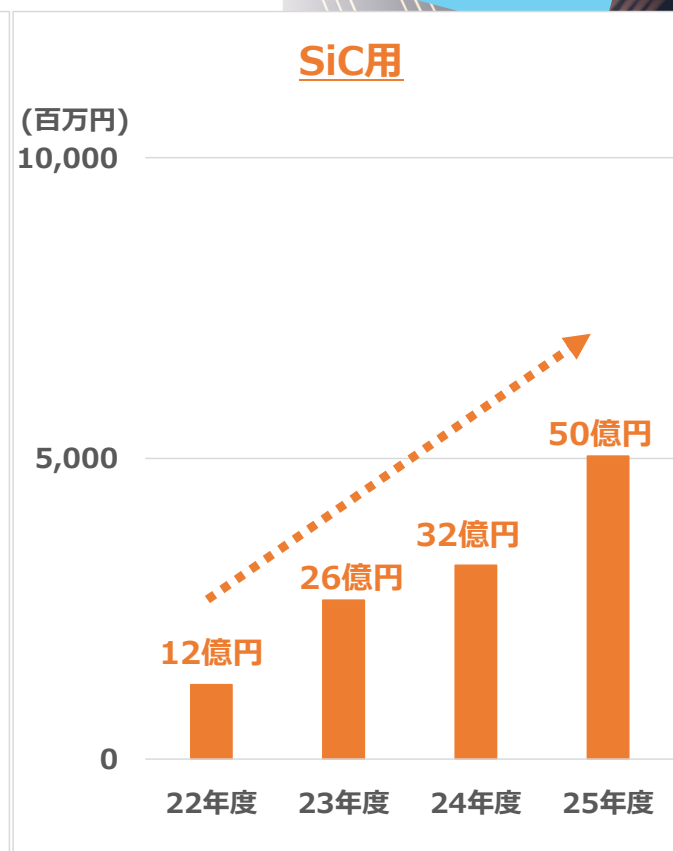
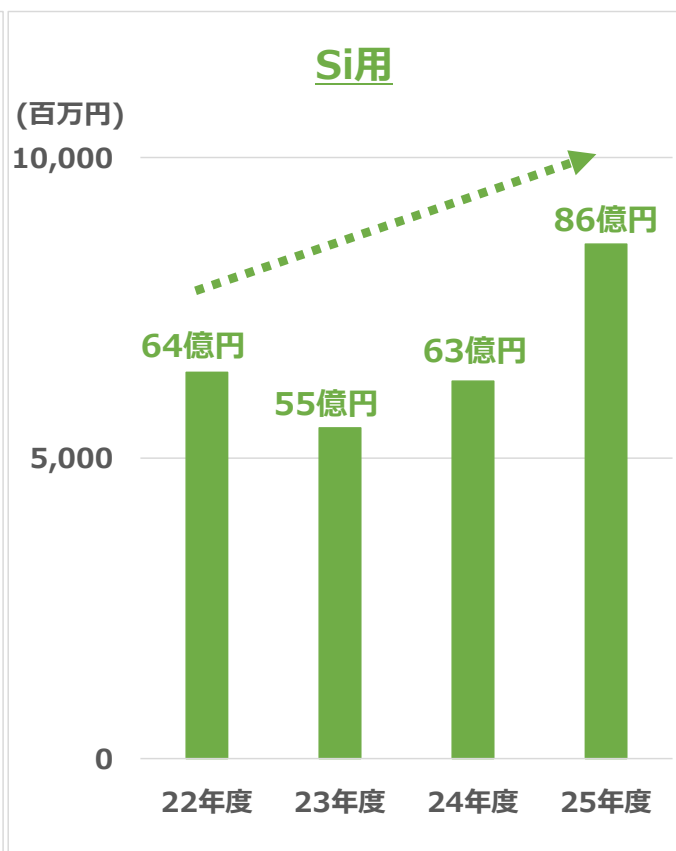
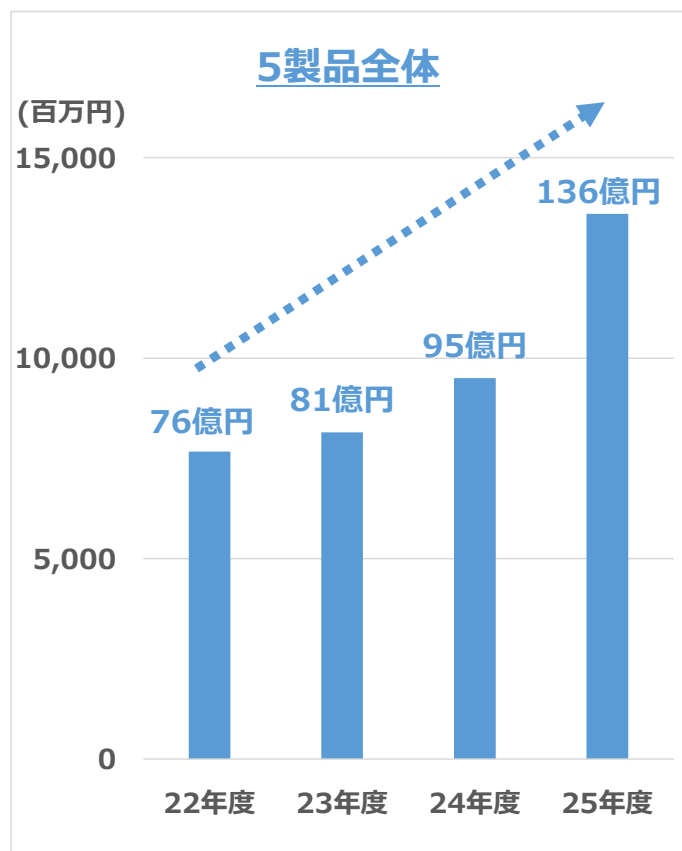
- 高収益製品の拡販に注力
- 展示会の活用





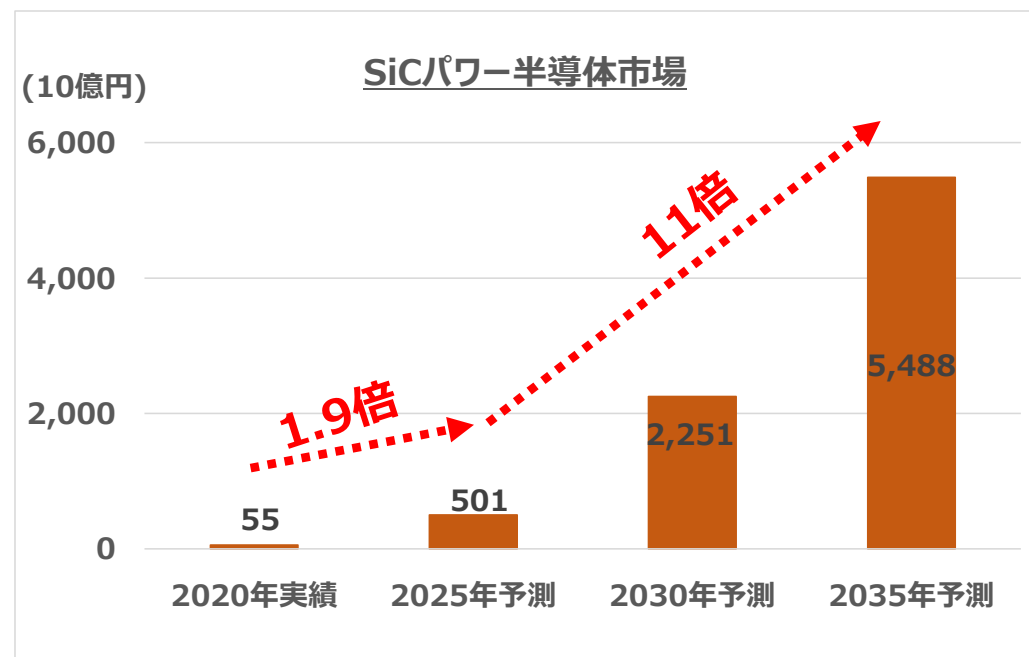
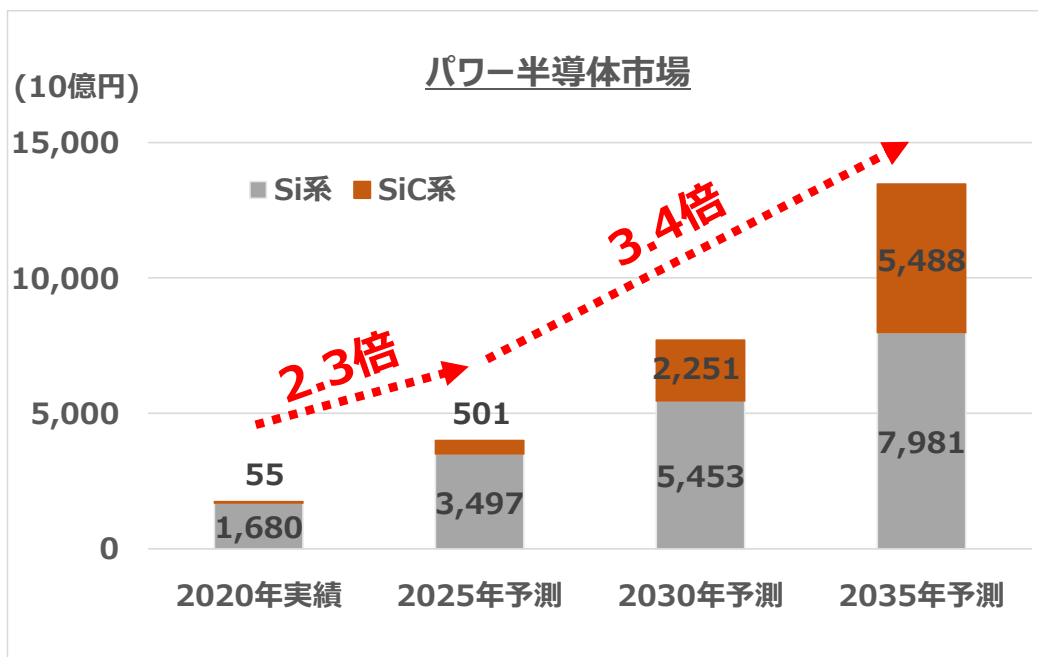
半導体注力

▶ 注力5製品の売上実績と目標



パワー半導体の市場

(出所：富士経済 2023年度次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望)



▼旭ダイヤがSiC系パワー半導体に注力している理由

- ◆ 今後もシリコン系に比べ高い成長率が見込めること
- ◆ Siに比べ加工が難しい材料のため、ダイヤモンド工具の使用量が非常に多い

経営基盤強化

▶ ITシステム：「経営数値の見える化」と「業務の効率化」を実現する

- 基幹システム刷新 《26年度から運用開始予定》
- 営業SFA（営業支援システム）を導入 《24年度から運用開始》

▶ グローバルガバナンス：中長期グループ経営方針に沿った経営の実現

- 海外子会社の事業計画に基づいた、組織・人材配置の最適化

▶ ブランディング：高品質で信頼できる旭ブランドのイメージ確立を目指す

- ウェブサイトを刷新 《2024年4月1日リニューアル》
- ブランディングチームの設置

▶ 人材育成：働きがいのある環境づくり

- 新人事制度による個々の特性を生かし成長を促進&適切な昇進昇格
- エンゲージメント調査、360度評価の実施

リソースの最適化

事業領域整理と社内外リソースの最適化

▶ グループ内最適化

- 事業領域の分析と不採算部門の整理
- 工場再編による増産体制の構築
(山梨旭への製品移管および是村旭の工場移転完了)

▶ 外部リソースの活用

- 製品の外部調達
- 業務提携（Tyrolit社との相互製品供給）

3



数値目標

	2023年度実績	2024年度見込	2025年度目標
連結売上高（百万円）	38,653	42,500	49,000
連結営業利益（百万円）	1,526	3,100	4,900
連結営業利益率（%）	4.0	7.3	10.0
ROE（%）	3.4	4.2	6.0以上
PBR（倍）	0.8	—	1.0以上

中期経営計画期間中の資本政策および株主還元

適用期間 2024年3月期～2026年3月期

- 配当性向50%以上
- 総還元性向120%以上（3年平均）

ROE：6%以上 PBR：1倍以上

3カ年創出キャッシュ

160億円～

純利益

減価償却費

政策保有株式の売却

資産の効率化

成長投資：150億円

株主還元：90億円

23年度実績

- 配当性向 73.8%
- 総還元性向 156%
- ROE 3.4%
- PBR 0.8倍

- 設備投資 50億円
- 株主還元 33億円



唯一無二 One and Only

世界の変化を先取りし、革新的技術とグローバルな組織力で、当社にしかできない製品・ソリューションを提供し続けます。

永続的な成長 Eternal Growth

モノづくりに携わる全世界のお客様から最も頼られる存在となり、永続的に成長する企業を目指します。

働きがい Job Satisfaction

仕事のやりがいを個々の成長に結び付けて持ち味を引き出し、全従業員がいきいきと働く企業を目指します。

・本資料には、過去の事実以外に今後の業績見通しや計画が記載されていますが、これらの見通しや計画は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

・2023年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

